



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203608449 U

(45) 授权公告日 2014. 05. 21

(21) 申请号 201320665216. 0

(22) 申请日 2013. 10. 23

(73) 专利权人 张青林

地址 230000 安徽省合肥市包河区东流东路  
1 号 1 幢 302 室

(72) 发明人 张青林

(51) Int. Cl.

H05K 1/11 (2006. 01)

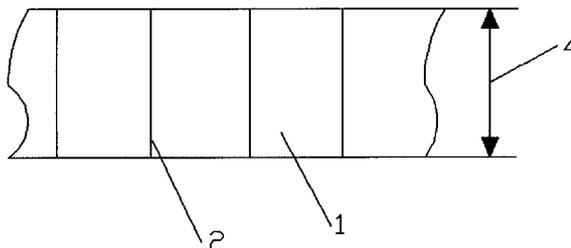
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种印制电路板修补铜箔

(57) 摘要

本实用新型属于电路板焊接铜箔,更具体的说涉及一种印制电路板修补铜箔,包括铜箔,所述铜箔是厚度为 0.2 毫米的铜片,宽度与待修复印制电路板导电路路宽度相当,长度任意,可卷曲成盘状,所述铜箔表面设置有刻痕,铜箔上下表面均喷涂有络合剂层。本实用新型技术方案的修补铜箔,将用于印制电路板上缺陷如裂隙、预留的测试点等进行修补修复,操作快速,节省印制电路板元器件焊接时间,克服焊锡在缺陷处难以连接,以致多次烫焊,导致缺陷处铜箔脱落翘起的现象,从而保证电路的正常工作,提高可靠性,延长电路的使用寿命,还可以修复那些略有瑕疵的印制电路板,降低印制电路板的报废率。



1. 一种印制电路板修补铜箔,包括铜箔,其特征在于:所述铜箔是厚度为0.2毫米的铜片,所述铜箔表面设置有刻痕,铜箔上下表面均喷涂有络合剂层。
2. 根据权利要求1所述的一种印制电路板修补铜箔,其特征在于:所述刻痕呈一定间距平行设置于铜箔表面。
3. 根据权利要求2所述的一种印制电路板修补铜箔,其特征在于:所述刻痕间的间距为1~2毫米。
4. 根据权利要求1所述的一种印制电路板修补铜箔,其特征在于:所述铜箔宽度与印制电路板导电路径宽度相适应。

## 一种印制电路板修补铜箔

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于电路焊接铜箔,更具体的说涉及一种可以对印制电路板进行缺陷修复的铜箔。

### 背景技术

[0002] 随着科技的发展,电子元器件及其产品发展更加的迅速,而印制电路板是电子元器件发展的首要器件,印制电路板的主要优点有:1、与图形具有重复性和一致性,减少了布线和装配的差错,节省了设备的维修、调试和检查时间;2、设计上可以标准化,利于互换;3、布线密度高,体积小,重量轻,利于电子设备的小型化;4、利于机械化、自动化生产,提高了劳动生产率并降低了电子设备的造价。这样对印制电路板的测试尤为重要,在印制电路板上预留有测试点,这些测试点在印制电路板与其元器件的焊接过程中就会出现连接不良的现象,严重影响电路的畅通性和正常工作。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种可以用于印制电路板缺陷和连接不畅处的修补修复的铜箔。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种印制电路板修补铜箔,包括铜箔,所述铜箔是厚度为 0.2 毫米的铜片,所述铜箔表面设置有刻痕,铜箔上下表面均喷涂有络合剂层。

[0005] 优选的,所述刻痕呈一定间距平行设置于铜箔表面。

[0006] 优选的,所述刻痕间的间距为 1 ~ 2 毫米。

[0007] 所述铜箔宽度与印制电路板待修复的导电路径宽度相适应,铜箔的长度不受限制,可以根据包装需要等卷曲成盘状。

[0008] 采用上述技术方案的有益效果是:采用本实用新型技术方案的一种印制电路板修补铜箔,将铜箔做成厚度为 0.2 毫米铜箔,用于印制电路板上测试点焊接处的修补连接,或用于印制电路板上出现裂缝处的连接修补,还可以用于多层印制电路板的电路连接焊接,如在主印制电路板上再叠加音乐集成电路 HY-100 这样的小印制电路板;在铜箔表面上设置刻痕,便于铜箔在使用时根据需要的长度和宽度进行剪断和折断,操作快速,节省印制电路板元器件焊接时间;采用本实用新型的铜箔有效的防止焊锡在缺陷处难以连接,以致多次烫焊,导致缺陷处铜箔脱落翘起的现象,从而保证电路的正常工作,提高可靠性,延长电路的使用寿命;本铜箔还可以修复那些略有瑕疵的印制电路板,降低印制电路板的报废率。

### 附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型一种印制电路板修补铜箔的主视图,

[0010] 图 2 为本实用新型一种印制电路板修补铜箔的侧面剖视图,

[0011] 其中,1、铜箔,2、刻痕,3、络合剂层,4、铜箔宽度。

### 具体实施方式

[0012] 下面结合说明书附图对本实用新型的技术方案和结构进行说明,以便于本技术领域的技术人员理解。

[0013] 如图 1 所示,一种印制电路板修补铜箔,包括铜箔 1,所述铜箔 1 是厚度为 0.2 毫米的铜片,所述铜箔 1 表面设置有刻痕 2,铜箔 1 上下表面均喷涂有络合剂层 3,宽度 4。

[0014] 所述刻痕 2 呈一定间距平行设置于铜箔 1 表面。

[0015] 所述刻痕 2 间的间距为 1 ~ 2 毫米。

[0016] 所述铜箔宽度 4 与印制电路板导电路径宽度相适应。

[0017] 上述结合附图对实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的这种非实质改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本实用新型的保护范围之内。

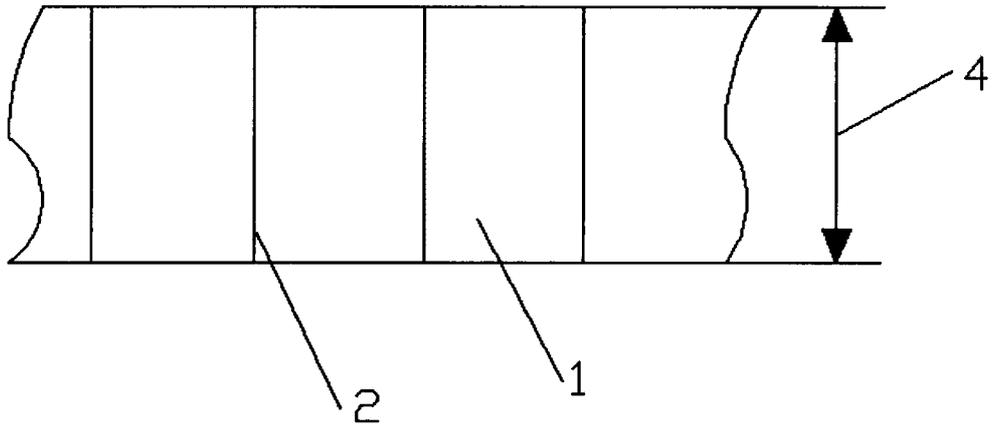


图 1

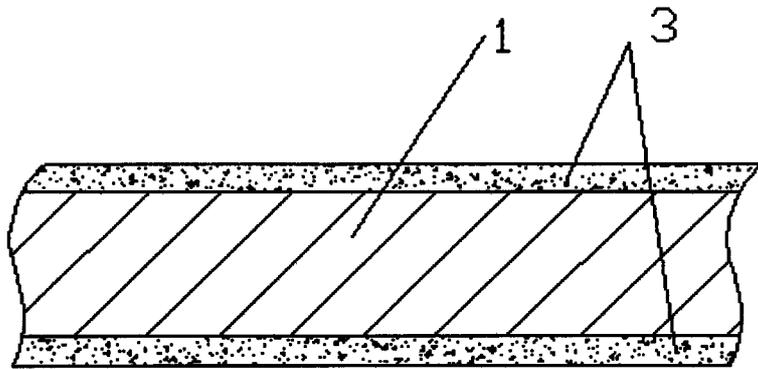


图 2